

Miniaturisierte Elektronikmodule für aggressive Umgebungen



Flüssigkristallpolymer (LCP), ein thermoplastisches dielektrisches Folienmaterial mit sehr geringer Wasserspeicherung (< 0,04 %), hoher chemischer Beständigkeit und geringer Wärmeausdehnung, ist bestens geeignet als Substratmaterial und Ummantelung für kleine miniaturisierte Elektronikmodule [1, 2]. LCP hebt sich von anderen Polymermaterialien ab, die in der Mikroelektronik Anwendung finden. Unter allen Polymermaterialien ist seine Wasser- und Gaspermeabilität am geringsten. Mit den entsprechenden Designüberlegungen können LCP-Packages ausreichende Dichtheit für die Anwendung in rauen Umgebungen erreichen. // Liquid crystal polymer (LCP), a thermoplastic dielectric film material with very low water storage (< 0.04 %), high chemical resistance and low thermal expansion, is best suited as substrate material and cladding for small miniaturized electronic modules [1, 2]. LCP stands out from other polymer materials used in microelectronics. Of all polymer materials, LCP has the lowest water and gas permeability. With appropriate design considerations, LCP packages can achieve sufficient leak tightness for use in harsh environments.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 3,18 €

3,40 €

Netto-Preis: 3,18 €

Enthaltene MwSt.: 0,22 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)